

2009 电子封装技术和高密度封装国际会议 (ICEPT-HDP)

暨电子封装技术国际会议十届 庆典

2009年8月10日 -- 13日, 北京, 中国

征文通知

我代表中国电子学会生产技术分会和电子封装专委会, 诚挚地邀请各位封装界的朋友参加将于2009年8月10日~13日在北京举行的电子封装技术和高密度封装国际会议(ICEPT-HDP 2009), 踊跃提交论文。

由中国电子学会生产技术分会(CEPS)主办的电子封装技术国际会议(ICEPT)将迎来第十届庆典。1994年清华大学、复旦大学、中国电子科学院、电子13所与电子58所五个单位共同发起, 由清华大学承办了首届电子封装国际会议。到2008年该会议已经由国内著名高校轮流承办了九届, 其中清华大学承办了三届, 其余六届分别由复旦大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学和上海交通大学承办。该会议为国内外学术界、产业界的专家学者和科技人员提供了一个交流电子封装技术新进展、新思路的重要平台, 得到了中国电子学会、中国科协、原信息产业部等上级单位的高度评价, 并得到了国际著名行业组织IEEE-CPMT和IMAPS长期的支持。2008年, 电子封装技术国际会议(ICEPT)和上海大学主办的高密度封装会议(HDP)合并为电子封装技术和高密度封装国际会议(ICEPT-HDP)于上海隆重召开, 得到国内外同仁热情支持和高度赞扬, 会议取得圆满成功。

ICEPT-HDP2009将于2009年8月10日~13日在中国北京举行, 由清华大学承办。会议将通过专题讲座、特邀报告、主题论坛、分会报告、**论文张贴**等形式对电子封装的各个技术领域中的最新进展进行交流。会议的详情和进展请随时查询会议网站 www.icept.org, 本届会议论文摘要的截止时间为2009年4月6日。

会议期间将举行第十届电子封装技术国际会议(ICEPT)庆典, 届时邀请长期支持大会的领导、专家、同仁欢聚北京。

大会主席 毕克允

中国电子学会 副总监
中国电子学会生产技术分会 理事长
中国半导体行业协会封装分会 理事长



会议主题

- **先进封装与系统封装:** 球栅阵列封装、芯片级封装、倒装芯片; 晶圆级封装、系统封装、封装内系统; 三维封装、堆叠封装、硅穿孔; 微纳米系统封装; 及其它各种先进的封装和系统集成技术。
- **高密度基板及组装技术:** 嵌入式无源和有源元件; 微孔洞、微连接、高密度互连、印刷电路板、高性能多层基板; 丝网印刷、回流焊; 及其它能够提高基板密度和性能的各种新型组装技术。
- **封装设计与模拟:** 各种新的封装/组装设计; 对各种电子封装的电、热、光和机械特性进行建模、模拟和验证的方法/技术/软件; 芯片-封装-印刷电路板的共同设计; 多功能和多尺度的建模、模拟、验证方法及其软件技术。
- **新兴领域封装:** 传感器、执行器、微电机系统、纳电机系统、微光电机系统; 光电子和发光二极管封装; 液晶显示, 无源元件, 及射频、功率、高压器件; 基于纳米线、纳米管、高分子聚合物的纳米器件等。
- **封装材料与工艺:** 键合丝、焊锡、芯片下填料、塑封料、粘剂、薄膜材料、介电材料、基板材料和导热材料的最新进展; 绿色电子材料、纳米材料和其它能够提高封装性能和降低成本的新型材料; 以及各种各样的封装与组装工艺。
- **封装设备及先进制造技术:** 新型的封装和组装制造设备; 质量监控、工艺过程控制及针对新兴领域封装的相关封装设备/测量方法的进展; 光刻、激光加工技术; 提升可制造性和良品率、降低成本及改善使用可靠性的新型封装/组装技术; 及用于工艺有效性模拟和监控, 成本分析等相关的先进方法/软件。
- **质量与可靠性:** 封装/组装制造质量监视与质量评估; 用于快速可靠性数据收集和分析, 可靠性模拟和寿命预测的先进方法/技术/软件; 新型领域封装技术中的相关可靠性问题; 及新的失效分析的方法/技术/工具。

重要会议日期

- **摘要截止** 2009年4月6日
- **摘要录用通知** 2009年4月20日
- **论文全文截止** 2009年7月13日

论文/摘要投稿

论文内容必须为具有原创性且没有发表过的技术成果。论文摘要须用大约500字的篇幅清楚地描述该项工作的背景、研究方法、结果和结论, 论文摘要还应包括关键的参考文献。

论文摘要必须用英文、按所附电子模板的要求撰写, 发送到 icept2009@tsinghua.edu.cn。

论文摘要的投稿截止日期为**2009年4月6日**, 来稿请注明您的联系方式, 包括电子信箱、通讯地址、联系电话和传真。大会将于**2009年4月20日**前通知您论文的录用情况。论文全文必须于**2009年7月13日**收到, 所有录用论文都将被收入IEEE会议论文集, 优秀论文将被推荐到IEEE-CPMT的相关期刊评审发表。

诚征参展商/赞助商

大会将为电子封装及相关工业的材料、设备、组件、和软件供应商, 制造商, 及服务商提供参展平台, 有意的参展商/赞助商请与大会通过电子邮件联系: icept2009@tsinghua.edu.cn

会议联系电子邮箱: icept2009@tsinghua.edu.cn

会议网站: <http://www.icept.org>